

BUSINESS REPORT
JEM TODAY

JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION

日本電子材料株式会社

証券コード 6855

トップメッセージ

株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
2024年度(2024年4月1日～2025年3月31日)の事業の概況をご報告申し上げます。

事業の経過及び成果

当社グループの主たる事業分野である半導体市場につきましては、生成AI向けの画像処理半導体や広帯域メモリー(HBM)等の先端半導体の需要が伸びました。一方で、自動車や産業機器向け等、生成AI用途以外の半導体市場の回復は遅れる状態で推移いたしました。

このような事業環境の中、当連結会計年度の売上高につきましては、非メモリー向けプローブカードは需要が低調に推移し、前連結会計年度をやや下回る結果となりました。一方、メモリー向けプローブカードは、当第4四半期(2025年1月～3月)において、国内及びアジアを中心とした海外向けに、先端半導体向け高付加価値製品の拡販が著しく進展しました。これに加え、製品在庫の出荷も寄与した結果、前連結会計年度を大きく上回りました。こうした状況を受け、全体としても前連結会計年度を大きく上回る結果となりました。

利益面につきましても、不安定な為替相場の影響や熊本新棟に係る一時的な費用等の発生があったものの、高付加価値製品を中心とした売上高の増加による、国内工場の稼働率向上等により、前連結会計年度を大きく上回る結果となりました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は23,829百万円(前連結会計年度比36.5%増)、営業利益は4,585百万円(前連結会計年度比426.7%増)、経常利益は4,640百万円(前連結会計年度比360.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては3,454百万円(前連結会計年度比455.0%増)となりました。

代表取締役社長
坂田 輝久

株主の皆様へ

半導体市場は中長期的には成長が見込まれるものの、米国の通商政策等による世界経済の下振れリスクや為替の不安定さ等、事業環境には依然として不確実性を伴っております。2025年度の見通しにつきましては、主要顧客及び非メモリー向けの需要回復はなお時間を要するものの、メモリー向け製品、とりわけ先端半導体向け製品の拡販は引き続き進展する見通しです。また、半導体市場の中長期的な成長に備え、積極的な先行投資を通じて、生産キャパシティ及び製品力の一層の強化を図ってまいります。

なお、当社は2025年4月6日をもちまして創立65周年を迎えることができました。これもひとえに、株主の皆様をはじめとする関係各位のご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

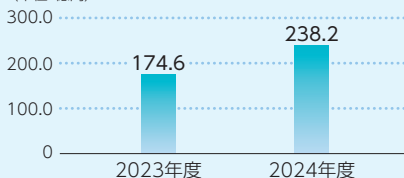
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2025年6月

業績の推移

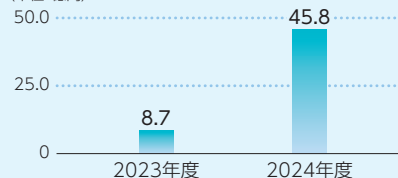
売上高

(単位:億円)



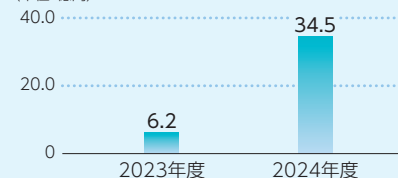
営業利益

(単位:億円)



親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:億円)



※記載金額未満は切り捨てて表示しております。

半導体の品質を支える。

スマートフォン、自動車、サーバー等多くの製品を支えている半導体。
当社グループは、半導体の品質を支える上で必要不可欠な
プローブカードの開発、製造、販売を行っております。



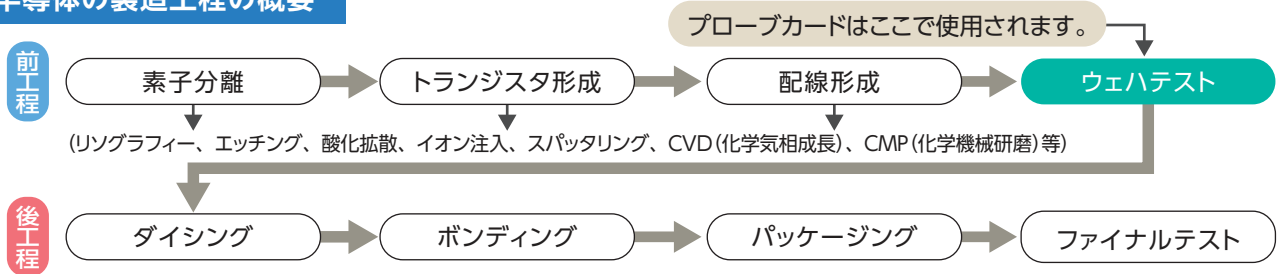
プローブカードの役割

プローブカードは、半導体の製造工程の中で、ウェハテストとよばれる電気的な検査を行う工程で用いられます。

そして、半導体ウェハ上につくられた半導体チップの電極に、最大10万本以上のプローブ(探針)を接触させ、電気信号を半導体テスターに伝える重要な役割を担っております。

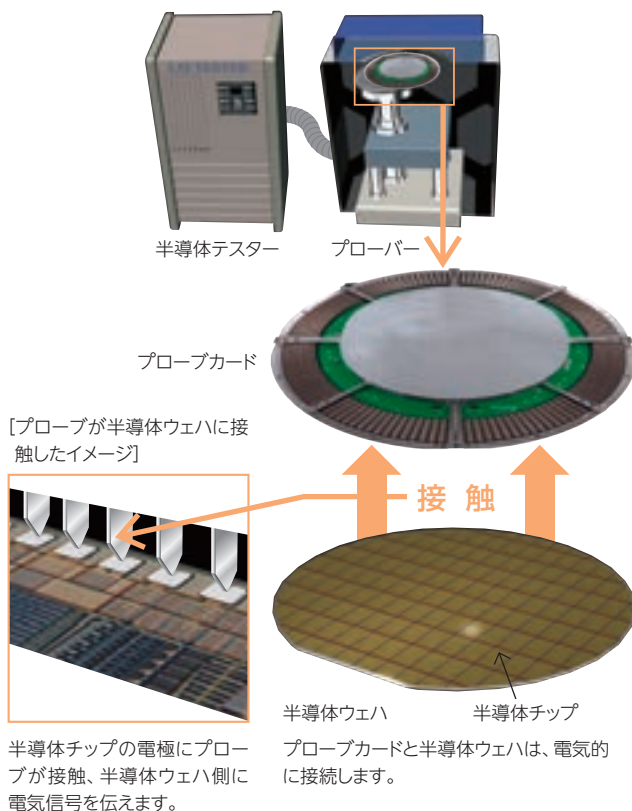
そのため、優れた電気的特性やミクロンオーダーの組立精度が求められます。

半導体の製造工程の概要



ウェハテストの概要

ウェハテストでは、半導体ウェハ上につくられた半導体チップの電極に、プローブの先端部分を接触させて電気的な検査を行い、半導体チップの良否判別が行われます。



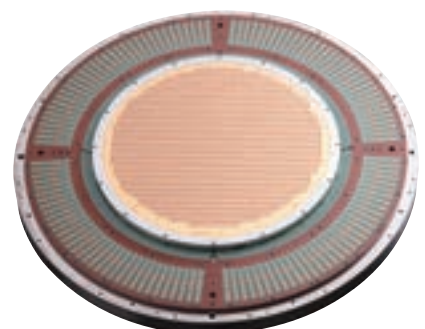
アドバンスドプローブカード(Mタイププローブカード)

半導体ウェハ上につくられた半導体チップを同時に多数測定することに優れた当社の主力製品です。データセンターやスマートフォン向けに市場が拡大しているメモリー半導体等の検査に使われています。たくさんのプローブを搭載した高密度なプローブカードを生産するため、MタイププローブカードにはMEMSとよばれる高度な技術が用いられています。



MEMS製造(クリーンルーム)

Mタイプ
プローブカード
(MC)



世界の主要な生産・販売拠点



これまで、当社は先駆的に海外にも生産・販売拠点を設けてまいりました。近年、半導体市場はアジアを中心に成長しており、海外戦略の重要性が増しております。今後も当社グループは、海外拠点のネットワークを活かした販売活動の充実を図るとともに、日本から各国拠点への一層の技術支援により、海外販売の強化を推進いたします。

技術の開発と製品化によって社会に貢献する。

TOPIC

2024-2026年度 中期経営計画進捗と市場動向の予測

実施1年目にあたる2025年3月期は、連結売上高・経常利益ともに業績予想を上回る結果となりました。

生成AIの普及に伴い、半導体市場は引き続き高付加価値な製品の需要拡大が期待されています。これにより、関連するプロセッサ市場も堅調な成長が予想されています。パソコンやスマートフォン向け半導体は、2025年後半に向けて緩やかな回復が見込まれています。しかし、米国の通商政策の動向により、半導体の流通が不安定になる可能性があり、これに伴って一時的な価格変動や在庫調整が発生する可能性があります。一方、車載向け半導体は、EV市場の低迷を受けて一時的に減速する見込みですが、中長期的には成長が期待されています。なお、米国の通商政策の影響については、直接的な影響は軽微と見込んでおりますが、間接的な影響についてはさらに注視してまいります。

熊本事業所 新棟完成披露式典開催

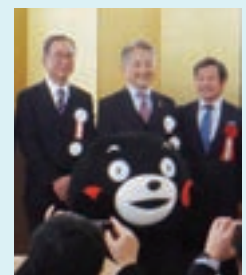
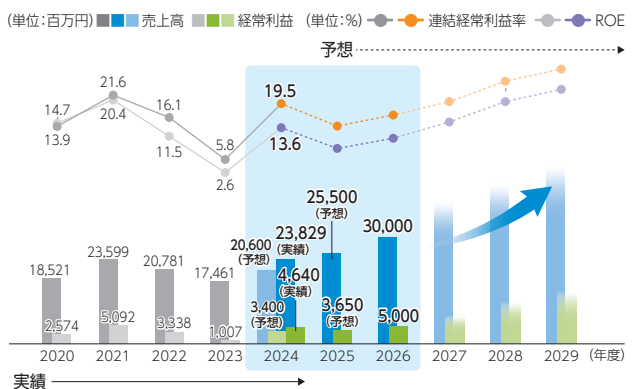
2025年3月7日、熊本新棟(第4工場棟、昨年10月に竣工)の完成披露式典を開催いたしました。当日は、国内外の半導体メーカーのお客様をはじめ、地元行政の皆様など、多くのご来賓の方々にご臨席賜りました。

熊本新棟は、本年4月に稼働を開始しており、生産キャパシティの向上により、これからも成長を続ける半導体市場を支えてまいります。

2024-2026年度中期経営計画

経営指標 常に連結経常利益率10%以上、株主資本利益率(ROE)10%以上

2026年度 売上高 30,000百万円 経常利益 5,000百万円





皆様、本当にありがとうございました

平素は格別のご高配を賜り、誠にありがたく御礼申し上げます。

このたび、私、大久保は取締役会長を退任し、名誉会長・相談役に就任いたしました。40年の永きにわたり、温かいご支援とお引き立てを賜りましたことに、心より感謝申し上げます。今後は経営の第一線から離れることとなりますが、当社の成長・発展を見守ることで、その責任を果たしてまいります。引き続き、坂田社長を中心にプローブカードを通じて半導体の品質を支え、技術の開発と製品化によって社会に貢献し、社業の発展に尽力してまいります。

何卒、一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

大久保 和正

会社概要

社名	日本電子材料株式会社
英訳名	JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION
住所	兵庫県尼崎市西長洲町二丁目5番13号 TEL.06-6482-2007 (代表)
設立	1960年4月6日
資本金	3,074,163千円
事業内容	●半導体検査用部品の開発・製造・販売 ●電子管部品の製造・販売
株式市場	東京証券取引所スタンダード市場
証券コード	6855

役員 (2025年6月25日現在)

取締役	
代表取締役社長 社長執行役員	さかた てる ひさ久 坂田 輝久
専務取締役 専務執行役員 MEMS統括部長 (MEMS統括担当)	みやもと よし ゆき幸 宮本 佳幸
取締役 上席執行役員 製品技術統括部長 (製品技術統括担当)	りゅう けい いち一 (新任) 龍 圭一
取締役	みや じま わたる渉* 宮 島 わたる
取締役 常勤監査等委員	あだち やす たか孝 足立 安孝
取締役 監査等委員	はま だ ゆき かず和* 濱田 幸和
取締役 監査等委員	ちばざくら えりか* 千葉櫻 えりか
*は社外取締役	
執行役員	
上席執行役員 生産統括部長 (生産統括、品質統括担当)	ふじ い あき ひこ彦 藤井 昭彦
上席執行役員 営業統括部長 (営業統括担当)	さわ い もり やす康 澤井 守康
執行役員 管理部門統括部長 (管理部門統括担当)	いし もと ひろ ひさ久 石本 浩久
執行役員 社長室長 (コンプライアンス担当)	むか い ひで き樹 向井 英樹
執行役員 先行開発統括部長 (先行開発統括担当)	よし だ たかし敬 吉田 敬

株式事項 (2025年3月31日現在)

発行可能株式総数	40,000,000株
発行済株式の総数	12,647,416株
株主数	11,619名

大株主 (2025年3月31日現在)

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行(株)	1,725千株	13.65 %
MSIP CLIENT SECURITIES	543	4.30
大久保和正	511	4.04
(有)大久保興産	466	3.69
(株)日本カストディ銀行	430	3.40
モルガン・スタンレーMUFJ証券(株)	379	3.00
HSBC BANK PLC A/C TTF	343	2.71
AIFMD GENERAL OMNIBUS	309	2.44
(株)三菱UFJ銀行	309	2.44
(株)SBI証券	230	1.82
大久保英正	213	1.69

(注)持株比率は、自己株式(15,900株)を除いて計算しております。

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月中
基準日	定時株主総会… 3月31日 剰余金の配当… 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
単元株式数	100株
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 電話 ☎ 0120-094-777 (通話料無料) ホームページ https://www.tr.mufg.jp/daikou/
公告の方法	当会社の公告方法は、電子公告といたします。ただし事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載します。当社の公告掲載URLは次のとおりです。 https://www.jem-net.co.jp/

- (注) 1. 株主様の住所変更、買取請求、その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等へお問合せ下さい。
2. 特別口座に記録された株式に関するお手続きにつきましては、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合せ下さい。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店でもお取次ぎいたします。
3. 未受領の配当金に関するご照会などは三菱UFJ信託銀行にお問合せ下さい。